

Three Bond 2217H

(1K-Epoxidharz/ Chipbonder)

Bei den Produkt Three Bond 2217H handelt es sich um ein einkomponentiges Epoxidharz, das speziell für die Oberflächenmontage entwickelt wurde, um Bauteile auf den Leiterplatten während des Bestückungs- und Lötvorgangs in Position zu halten. Dieser SMD-Klebstoff (Surface Mount Adhesives) zeichnet sich durch schnelle Auftragungsmethoden und verkürzte Aushärtezeiten aus und gewährleistet eine ausgezeichnete Prozess-Sicherheit.

1. Merkmale

- Die einfache Auftragung mit voll-automatischen Dispensern und Schablonendruckern ermöglicht eine schnellere Bestückung.
- Die schnelle Aushärtung des Harz bei niedrigen Temperaturen (80°C~) ermöglicht verkürzte Durchlaufzeiten (ex. 150°C x 1 ~ 5 min).
- Da das Harz zu über 99 % aus nichtflüchtigen Substanzen besteht, tritt während der Aushärtung so gut wie keine Ausgasung und Schrumpfung auf.
- Das ausgehärtete Harz zeichnet sich durch exzellente elektrische Eigenschaften sowie durch ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit aus.
- Hervorragend als Chipbonder von Quad Flat Packages (QFP) geeignet.

2. Typische Eigenschaften

Prüfkriterium	Ergebnis	Einheit
Farbe	Rot	
Viskosität bei 25°C	196	Pa·s
Dichte bei 25°C	1,25	g/cm ³
Thixotroper Index (4 : 20 rpm)	2,9	
Aushärungszeit bei 80°C	200 ~ 230	Sek.
100°C	70 ~ 100	Sek.
120°C	50 ~ 80	Sek.
150°C	35 ~ 65	Sek.
Scherfestigkeit Fe/Fe *	25,2	MPa
Shore-Härte *	89 D	
Glasumwandlungs- temperatur *	99	°C
Wärmeausdehnungs- koeffizient *	77 x 10 ⁻⁶	°C ⁻¹
Wasseraufnahme (100°C x 1 h) *	+ 0,62	%
Lagerfähigkeit bei 5°C	6	Monate

* Aushärtebedingung : 120°C x 10min

3. Hinweise

- Das Epoxidharz im Originalbehälter dicht geschlossen halten und an einem dunklen, trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort aufbewahren.
- Lassen Sie das Produkt vor dem Öffnen des Behälters erst Raumtemperatur erreichen, da sich ansonsten Tauniederschlag bilden kann.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Feuchtigkeit, Fett und sonstige Verunreinigungen von den Fügeflächen entfernt werden.
- Das Epoxidharz je nach Fugenbedingungen (Breite, Rautiefen, Unebenheiten usw.) in entsprechender Menge gleichmäßig auf eine der Fügeflächen auftragen und die Teile sofort zusammenfügen, richtig positionieren und fixieren.
- Der Aushärtungsgrad variiert in Abhängigkeit von der Schichtdicke, der Umgebungstemperatur und der Prozessdauer.
- Bei der Verwendung von Präzisionsharzen können Veränderungen der Viskosität als Funktion der Umgebungstemperatur überprüft werden.
- Einmal ausgegossenes Produkt sollte nicht mehr in den Originalbehälter zurückgegossen werden. Überschüssiges Material kann problemlos mit einem Tuch entfernt werden.

4. Verkaufseinheiten

Verschiedene 20 ml, 30 ml (u.a. Semco, Panasert, Musashi und Fuji) und 370 g Kartuschen sowie 1 kg Dosen und 230 g DEK Pump Print Kassetten

Die hier angegebenen Daten und Empfehlungen wurden nach bestem Wissen erstellt und können aufgrund unserer Testergebnisse und Erfahrungen als zuverlässig angesehen werden. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungshinweise nicht verantwortlich sein können. Vor dem Gebrauch empfehlen wir, Versuche durchzuführen, ob sie den vom Anwender gewünschten Zweck erfüllen. Ein Anspruch daraus ist jedoch ausgeschlossen. Für falschen und zweckfremden Einsatz trägt der Anwender die alleinige Verantwortung.